

Workshop „Beschichtung elektronischer Baugruppen“



Heutzutage werden elektronische Baugruppen immer extremen Klimabedingungen wie Hitze, Kälte sowie Trockenheit und Feuchte ausgesetzt. Um die Funktionszuverlässigkeit dabei sicherzustellen, ist eine Schutzlackierung notwendig.

Zusammen mit führenden Herstellern aus der Lackier- und Beschichtungstechnik veranstaltet Zestron einen Workshop zum Thema „Beschichtung elektronischer Baugrup-

pen“. Außer den klassischen Beschichtungsverfahren werden auch die aktuellen Entwicklungen in der optimalen Vorbehandlung der Baugruppen vor dem Beschichten und der Prüfung der Baugruppen auf Klimazuverlässigkeit behandelt. Der nächste Termin: 23.10.2008.

► Zestron
 Fax: 0841/635-40
 a.koegel@zestron.com
 workshop@zestron.com

Wo Forschung großgeschrieben wird

In der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der KSG Leiterplatten GmbH werden auch Projekte bearbeitet, die sich noch nicht als Standard in der Leiterplattentechnik herausgebildet haben. Das sind Themen wie Miniaturisierung und enge Tolerierung des Platinendesigns, Optimierung der Signalintegrität im Hochfrequenzbereich, Erweiterung der thermischen Leistungsfähigkeit und grundsätzliche Hochstromanforderungen.

KSG bietet seinen Kunden Beratung unter thermischen Gesichtspunkten bezüglich Substratauswahl inklusive

konstruktiver Gestaltungsmöglichkeiten, Vergleichsrechnungen für Änderungen diverser Parameter und Vorschläge zur Modifikation eines bestehenden Layouts und zur Anordnung der „Wärmequellen“, wenn dies aus thermischer Sicht eine Verbesserung verspricht.

Aktuelle Neuheiten aus der F&E-Abteilung der KSG sind das Prägen von Leiterstrukturen sowie die Integration von Polymerelektronik in den Leiterplattenaufbau.

► KSG Leiterplatten
 Fax: 003721/266-101
 www.ksg.de

Spezialvliese und Papiere zur Reinigung



Como hat mit einem bekannten Hersteller von hochwertigen Vliesen und Splicing ein erfolgreiches und für den Anwender sehr wirtschaftliches Konzept für die Schablonenunterseiten-Reinigung entwickelt.

Die Hoang-PVM GmbH hat sich ganz den kundenspezifischen Anforderungen und deren Umsetzung gewidmet und sich mit seinen neuen Produkten Como-CleanMaster und Splicing den steigenden Qualitätsstandards bei der optimalen Reinigung während des Siebdruckprozesses angepasst und seine Produktpalette erweitert. Dabei wird die Stabilität des gesamten Prozess-Engineerings nicht außer Acht gelassen. Aus diesem Grund setzt man

immer mehr Hilfsstoffe ein, welche die Qualität des Finishing Products beeinflussen. Man hat jedoch im Laufe der Zeit erkannt, dass das heutige Einsparungspotenzial beim Einsatz von Standardtüchern bzw. Reinigungspapieren für die Schablonenunterseiten-Reinigung oftmals in einem besseren Verhältnis steht, als man denkt.

Als erstes Europa-Vertriebsunternehmen bietet Hoang auf www.hoang-pvm-engineering.com die Möglichkeit, sich über die umfangreichen technischen Daten zu informieren.

Es zeigt sich immer mehr, dass die Anwender heutzutage nicht nur auf gute Qualität bestehen, sondern sich auch wegen des Preisdrucks aus anderen Ländern nach neuen kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Produkten umsehen.

► Hoang PVM
 Fax: 02102/7407 871
www.hoang-pvm-engineering.com

Leiterplatten in Reinraumqualität

Um die Basisqualität für das Bedrucken von Leiterplatten in SMD-Technik bei weiterhin zunehmender Miniaturisierung zu gewährleisten, ist die Eingangsgüte von entscheidender Bedeutung. Da bei Anlieferung die Qualität nicht immer gewährleistet ist, wird zur Sicherung der Qualität eine professionelle Reinigung zwingend erforderlich. Hierfür hat die ANS answer elektronik Service- & Vertriebs GmbH den Antistatic Dedusting Conveyor PB500/ADC entwickelt.

Die Einsatzcharakteristik ist die berührungslose antistatische Reinigung von Leiterplatten während des Transports mit dem Dreiphasensystem: Messung der elektrosta-

tischen Aufladung, gesteuerte Ladungsneutralisierung durch ionisierte Luft und Absaugung der neutralisierten Staubpartikel.

Die gereinigten und ladungsneutralen Leiterplatten werden in Reinraumqualität zum Lotpastendruck weitergeleitet. Damit wird der gesamte SMD-Prozess verbessert – für Bestückung mit µBGA, 0201- und 0402-Bauelementen ist das innovative ANS-Gerät unverzichtbar. Der Reinigungsprozess findet in einer abgeschirmten Atmosphäre statt.

► ANS answer elektronik
 Fax: 06047/9600-50
info@ans-answer.com
www.ans-answer.com